



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN23840XD

Issue Date: 10 Feb 2021

Title of Change:	Bump Site Transfer from FCI to ASE-KH	
Proposed First Ship date:	05 Oct 2021 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Tammy.Olney@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.samples@onsemi.com >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact < PCN.Support@onsemi.com >	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Parts using the ASE-KH bump flow will be identified by a new plant code	
Change Category:	Assembly Change, Bump Site Change	
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Transfer	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
None	ASEKH, Taiwan (Kaohsiung)	
	Flipchip International, USA	
Description and Purpose:		
	Before Change Description	After Change Description
Bump Site	Flipchip International, USA	ASEKH, Taiwan (Kaohsiung)
Note: Initial comparative analysis of the material composition is ongoing. Customer will be notified at a later date.		

**Qualification Plan:**QV DEVICE NAME : NCP333FCT2GRMS : 74001PACKAGE: WLCSP

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	TA=125C, bias at 1.2X Nominal (not to exceed Max rated)	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -40°C to +125°C; for 850 cycles	850 cyc
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 100% of rated V or 100V max	96 hrs
uHAST+PC	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	IR reflow at 245C or 260C (pkg dependant)	
SD	JSTD002B	Ta=245C 10 sec dwell B102	
PD		per marketing outline drawing	

QV DEVICE NAME : NCP451AFCT2GRMS : 74110PACKAGE: WLCSP

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	TA=125C, bias at 1.2X Nominal (not to exceed Max rated)	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -40°C to +125°C; for 850 cycles	850 cyc
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 100% of rated V or 100V max	96 hrs
uHAST+PC	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	IR reflow at 245C or 260C (pkg dependant)	
SD	JSTD002B	Ta=245C 10 sec dwell B102	
PD		per marketing outline drawing	

Estimated date for qualification completion: 30 June 2021

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
NCP339AFCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G
NCP339BFCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G
NCP433FCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G
NCP435FCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G
NCP451FCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN23840XD

Issue Date: 10 Feb 2021

NCP456RFCCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G
NCP459FCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G
NCP333FCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G
NCP335FCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G
NCP451AFCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23840XD

発行日: 10 Feb 2021

変更件名:	FCI から ASE-KH へのバンブ拠点移管	
初回出荷予定日:	05 Oct 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または Tammy.Olney@onsemi.com にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または PCN.Samples@onsemi.com にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、 PCN.Support@onsemi.com にお問い合わせください。	
部品のマーキング/変更のトレーサビリティ:	ASE-KH バンブフローを使用する製品は、新しい工場コードにより識別されます。	
変更カテゴリ:	組立の変更, バンブ拠点の変更	
変更サブカテゴリ:	製造拠点の移管	
影響を受ける拠点:		
外部製造工場 / 下請業者拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
なし	ASEKH, Taiwan (Kaohsiung)	
	Flipchip International, USA	
説明および目的:		
	変更前の表記	変更後の表記
バンブ拠点	Flipchip International, USA	ASEKH, Taiwan (Kaohsiung)
注: 材料組成の初期比較分析は進行中です。お客様には後日通知されます。		



認定計画:

デバイス名 : NCP333FCT2GRMS : 74001パッケージ : WLCSP

テスト	規格	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	TA=125C, bias at 1.2X Nominal (not to exceed Max rated)	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -40°C to +125°C; for 850 cycles	850 cyc
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 100% of rated V or 100V max	96 hrs
uHAST+PC	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	IR reflow at 245C or 260C (pkg dependant)	
SD	JSTD002B	Ta=245C 10 sec dwell B102	
PD		per marketing outline drawing	

デバイス名 : NCP451AFCT2GRMS : 74110パッケージ : WLCSP

テスト	規格	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	TA=125C, bias at 1.2X Nominal (not to exceed Max rated)	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -40°C to +125°C; for 850 cycles	850 cyc
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 100% of rated V or 100V max	96 hrs
uHAST+PC	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	IR reflow at 245C or 260C (pkg dependant)	
SD	JSTD002B	Ta=245C 10 sec dwell B102	
PD		per marketing outline drawing	

認定完了予定日 : 30 June 2021

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
NCP339AFCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G
NCP339BFCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G
NCP433FCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G
NCP435FCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G
NCP451FCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G
NCP456RFCCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G
NCP459FCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23840XD

発行日: 10 Feb 2021

NCP333FCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G
NCP335FCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G
NCP451AFCT2G	NCP333FCT2G, NCP451AFCT2G